

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	107 年度	106 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		\$37,889,542	\$ 37,077,396	\$812,146	2.19
投 資		2,067,913	2,300,786	(232,873)	(10.12)
不動產、廠房及設備		61,980,853	58,663,021	3,317,832	5.66
無形資產		1,162,204	1,249,649	(87,445)	(7.00)
其他資產		494,989	367,576	127,413	34.66
資產總額		103,595,501	99,658,428	3,937,073	3.95
流動負債		18,580,671	21,788,688	(3,208,017)	(14.72)
非流動負債		31,937,463	28,186,311	3,751,152	13.31
負債總額		50,518,134	49,974,999	543,135	1.09
股 本		7,791,466	7,791,466	0	0.00
資本公積		127,734	119,593	8,141	6.81
保留盈餘		33,361,411	30,555,478	2,805,933	9.18
其他權益及庫藏股票		(277,385)	(405,727)	128,342	31.63
母公司業主之權益		41,003,226	38,060,810	2,942,416	7.73
非控制權益		12,074,141	11,622,619	451,522	3.88
股東權益總額		53,077,367	49,683,429	3,393,938	6.83
重大變動項目分析說明如下：					
1.其他資產增加：主要係遞延所得稅資產增加所致。					
2.其他權益及庫藏股票增加：主要係 107 年度國外營運機構財務報表換算兌換利益所致。					

註：上列財務資料來源為經會計師查核簽證之合併財務報告。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	107 年度	106 年度	增 (減) 金額	變 動 比 例 (%)	變 動 分 析
營業收入淨額	\$ 68,039,379	\$ 59,632,083	\$ 8,407,296	14.10	
營業成本	54,209,337	46,933,571	7,275,766	15.50	
營業毛利	13,830,042	12,698,512	1,131,530	8.91	
營業費用	4,046,388	3,624,488	421,900	11.64	
營業淨利	9,783,654	9,074,024	709,630	7.82	
營業外收入及支出	(348,317)	(186,746)	(161,571)	(86.52)	1
稅前淨利(損)	9,435,337	8,887,278	548,059	6.17	
所得稅費用	1,922,775	1,596,003	326,772	20.47	2
本期淨利	\$ 7,512,562	\$ 7,291,275	\$ 221,287	3.03	
增減變動分析：					
1.營業外收入及支出增加：主要係認列非金融資產減損損失所致。					
2.所得稅費用增加：主要係稅前淨利增加所致。					

註：上列財務資料來源為經會計師查核簽證之合併財務報告。

(二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

根據 WSTS (The World Semiconductor Trade Statistics) 在 107 年 11 月預估，108 年全球半導體市場銷售值將達 4,901 億美元，與 107 年相比，成長 2.6%；工研院產科國際所則預估 108 年台灣半導體產業產值將成長 5%。預期 108 年需求狀況，半導體最大應用的智慧手機出貨與電腦出貨量，已逐年趨緩甚至衰退，108 年全球手機出貨部分之出貨量預估將成長 5.3%；PC 部份，出貨量預估將小幅成長 1.4%；WSTS 預估 108 年光電元件、感測器、分立元件、類比 IC、邏輯 IC、微元件銷售額預估將會分別年增 6.8%、5.1%、3.9%、3.8%、3.8%與 3.0%，而記憶體將出現成長率下滑的狀況，銷售額將會微幅下滑 0.3%。AI 智慧系統與 IoT 物聯網科技時代來臨，將引領數據處理應用比重高度成長，工業用與車輛用的半導體未來也因之持續向上成長。中國是半導體最大市場，積極在地化發展為半導體工廠，109 年之前中國的半導體在地化產值就會超過 2 仟億人民幣，唯美中貿易狀況需密切注意；而被視為下一個成長引擎的印度和東協等國家，雖然人口眾多，人均所得有所成長但仍偏低，加上相關通訊硬體建設不足，削弱行動裝置需求的成長速度。

本公司在 DRAM、NAND Flash、Logic 及先進產品元件預計將呈現微幅衰退，對本公司未來之財務業務尚無重大影響。

訂定 108 年預期銷售數量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 110 億顆
測試	約 70 億顆
凸塊(Bumping)	約 80 萬片
晶圓測試	約 360 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SIP)	約 8,000 萬個

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期 初 現金餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年來自 投資活動 淨現金流量	全年來自 籌資活動 淨現金流量	匯率變動對 現金及約當 現金之影響	現金剩餘 數
17,716,582	20,207,098	(16,191,623)	(3,383,088)	195,173	18,544,142
107 年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：營業活動現金流入量主要係 107 年度折舊及獲利增加。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係 107 年度取得不動產、廠房及設備之現金流出。					
(3)融資活動：融資活動現金淨流出量主要係 107 年度發放股東現金紅利。					

(二)流動性不足之改善計畫：

107 年度現金流量無流動性不足之情形，故不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期 初 現金餘額	預計全年 來自營業 活動淨現 金流量	預計全年 現金流 出量	現金剩餘 數	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
18,544,142	18,000,000	18,000,000	18,544,142	—	—
1.108 年度現金流量變動情形分析					
(1)營業活動：營業活動現金流入量主要係 108 年度預計獲利加計折舊等。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係預計 108 年度取得不動產、廠房及設備與長期投資之現金流出。					
(3)融資活動：融資活動現金流出量主要係預計 108 年度支付股東股利及償還銀行借款之現金流出。					
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司 107 年度重大資本支出主要為取得不動產、廠房及設備，資金來源係以自有資金及銀行借款支付。由於本公司所處半導體產業之產品及技術世代交替迅速，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能，以配合產品市場的變化及客戶的需求，以維持公司之競爭力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫

本公司轉投資政策主要係為配合公司深耕本業，並以強化與主要客戶間之策略聯盟關係及延伸相關產業之營業觸角為方向，期以投資收益增進股東權益。

本公司考量未來營運之成長，積極規劃拓展日本市場，以提升公司全球競爭優勢，於 106 年 1 月投資設立力成科技日本合同會社，並於 106 年 4 月董事會通過授權董事長在不超過日幣 145.2 億元(約折合美金 1.32 億元)之額度內，分次增加對力成科技日本合同會社之投資，以透過其公開收購日本上市公司 Tera Probe Inc. 股份及 Micron Akita, Inc. 之全部股份。

公開收購日本上市公司 Tera Probe Inc. 之股份已於 106 年 6 月初完成，收購價格為每股日幣 1,100 元，收購總金額日幣 4,884,330 仟元。收購股數佔被收購公司 Tera Probe Inc 普通股總股數的 47.84%，加計母公司力成科技原持有之 11.6%，合計持有 59.44%。由於本公司對該公司已有絕對控制權，故該公司及其子公司 Tera Probe Aizu, Inc 與晶兆成科技(股)公司皆成為本公司之子公司。106 年 8 月初完成購買 Micron Akita, Inc. 之全部股份，實際成交金額為美金 48,917 仟元，交易完成後，隨即更名為 Powertech Technology Akita Inc.(力成科技秋田株式會社)。為支應該子公司未來營運之資金需求，同年 10 月，力成科技日本合同會社參與該子公司之現金增資，金額為日幣 980,000 仟元，完成後累計持有股數為 6,202 股，投資金額為日幣 5,736,994 仟元。經由上述之交易，原採權益法之轉投資公司皆列入合併財務報表，故 107 年度認列之投資損益為 0 仟元。

未來一年投資計畫將視整體產業狀況與公司事業發展之需求，在鞏固策略聯盟合作關係與延伸相關產業營業觸角的方向下，經審慎評估後提報董事會核議。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動之影響及因應措施

本公司所處半導體封裝測試業屬資本密集產業，機器設備的投資金額較大，資金來源除自有資金外，以銀行借款為主，故本公司損益受到利率變動之影響。對此風險本公司除定期評估銀行借款利率與市場平均利率之水準外，並適時向往來銀行洽商取得較優惠之借款利率。

2.匯率變動之影響及因應措施

(1)匯率變動之影響

本公司 107 年度外銷比重約為 79.79%，此為外幣收入之主要來源，幣別則以美元為主。而本公司部分機器設備及原物料亦從國外進口，大部份以美元或日幣

計價，因此，不論收入或支出均受匯率波動之影響。本公司 107 年度匯兌利益為 215,339 仟元。

(2)因應匯率變動之具體措施：

- 進貨與收入產生相互沖抵之結果，使匯率之變動產生自然避險之效果。
- 財務人員蒐集有關匯率變化之訊息，參酌往來銀行銀根鬆緊狀況，匯率走勢分析及市場外匯需求狀況，以作為因應匯率變動之參考。
- 依據未來外幣需求情況下，適時買入外幣，以確定成本並降低匯率變動所造成之影響。
- 運用銀行額度適當時機將外幣貸款轉換為新臺幣之借款。
- 運用遠期外匯之衍生性商品交易，規避外幣計算之資產或負債及預期交易因匯率變動產生之風險。

3.通貨膨脹情形：

本公司 107 年度損益並無明顯受通貨膨脹之影響，未來將視變動情形因應調整。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司並無從事高風險、高槓桿之投資交易。
- 2.依本公司背書保證處理程序規定，本公司得以公司名義對持股 50%以上子公司在一定限額內對其背書保證。為因應新加坡子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.辦理短期借款所需，本公司於 103 年度提請董事會同意授權董事長在美金五千萬元之額度內，以公司名義對前述借款辦理背書保證。104 年度期間本公司已完成對該子公司之增減資，降低了該公司對銀行借款之需求額度，故於 105 年 3 月經董事會通過將背書保證限額調整為美金三千萬元。截至年報刊印日止，本公司對子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.之背書保證最高限額仍為美金三千萬元，實際動用額度為美金 4,620 仟元(約新台幣 142,412 仟元)。另外，同上述理由，本公司亦於 106 年 5 月 5 日第七屆第 20 次董事會決議通過對子公司力成科技(蘇州)有限公司之背書保證限額為美金二千萬元，期間該子公司有若干動用額度，而截至年報刊印日止，該子公司實際動用額度為美金 0 仟元。

依本公司背書保證處理程序規定，本公司及子公司整體對單一企業背書保證責任之限額及對外背書保證總額，分別以不超過本公司淨值的 10%及 50%為限，本公司 107 年 12 月 31 日之淨值為 41,003,226 仟元，故本公司對單一企業背書保證責任之限額及對外背書保證總額分別為 4,100,323 仟元及 20,501,623 仟元，符合本公司背書保證處理程序及相關法令之規定。

- 3.為因應子公司擴充產能之資金需求，本公司於 107 年 3 月 16 日第八屆第 5 次董事會決議通過資金貸與力成科技(蘇州)有限公司及 Powertech Technology (Singapore) Pte Ltd.，金額分別為美金 2,400 萬元及美金 3,000 萬元為上限，並得分次貸與；貸款期間為一年，借款利率依借款當日銀行短期貸放利率計算，預計

年利率約 2.2%。截至年報刊印日止，上述兩家子公司力成科技(蘇州)有限公司及 Powertech Technology (Singapore) Pte Ltd.分別動支美金 20,500 仟元(約新台幣 631,913 仟元)及美金 21,000 仟元(約新台幣 647,325 仟元)。

依本公司資金貸與他人作業程序之規定，有短期融通資金之必要之公司或行號，對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額，分別以不超過本公司淨值的 5% 及 10% 為限。本公司 107 年 12 月 31 日之淨值為 41,003,226 仟元，故本公司對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額分別為 2,050,161 仟元及 4,100,323 仟元，符合本公司資金貸與他人作業程序及相關法令之規定。

另外，本公司於 106 年 6 月初完成公開收購 Tera Probe Inc. 成為子公司時，該公司原已資金貸與其 100% 子公司 Tera Probe Aizu, Inc.，額度為日幣 8 億元，108 年 1 月經董事會決議降低額度為日幣 7.6 億元，截至年報刊印日止，實際動用金額為日幣 5.6 億元(約新台幣 155,904 仟元)。同上述資金貸與他人作業程序之規定，Tera Probe, Inc. 107 年 12 月 31 日之淨值為 6,464,110 仟元(日幣 23,218,786 仟元)，故 Tera Probe, Inc. 對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額分別為 323,206 仟元(日幣 1,160,939 仟元)及 646,411 仟元(日幣 2,321,879 仟元)，亦符合本公司資金貸與他人作業程序及相關法令之規定。

4. 本公司 107 年度及截至年報刊印日止，僅為規避以外幣計價之淨資產或淨負債因匯率波動所產生之風險而進行短期外匯交易，未從事投機性交易，因屬避險性質，故對本公司不會造成重大之獲利或虧損。

(三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司自成立以來即致力於封裝測試人才的培訓，於 87 年即成立研發部門，持續進行封裝測試新製程、新技術之研發及引進；並於 95 年成立研發技術中心，未來將配合半導體記憶體主件朝多功能、高速化、高信賴度及高密度化方向發展及配合客戶新產品之開發情形，積極發展及引進新技術。未來研發計畫請詳伍、營運概況之一、(一)、4. 計劃開發之新商品(服務)之說明。預計 108 年度投入之研發費用為新台幣 1,691,130 仟元，由於本公司編列研發費用之預算較為保守，實際執行預算結果應將與 107 年相當。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，而最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司所處半導體產業，產品及技術之世代交替迅速，為配合產品市場的變化及客戶的需求，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能。為降低產能過度擴充之風險、有效運用資金掌握產品發展趨勢，本公司與主要客戶建立策略聯盟之合作關係，以共同提升先進技術之能力。另外，利用轉投資相關企業，佈建完整的產品線，藉以分散產業變化帶來的風險，並加強成本控制、現金管理來維持公司的競爭力，以控制對公司財務業務的影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，一向秉持專業及誠信之經營原則，持續積極強化公司內部管理及提升品質管理能力，並進一步增加客戶對公司之信任。本公司企業形象良好，近年並無企業形象改變而造成企業危機之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於 107 年及截至年報刊印日止，尚無進行併購之情形。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司為配合業務的擴展及持續先進封裝測試產品製程與技術開發的策略，近年來我們著力於面板級扇外型封裝(Fan-Out Panel-Level Packaging, FOPLP)技術及製程之研發，以提供客戶後摩爾定律之一解決方案。為建立此高階封裝製程之量產基地，於 107 年 9 月於新竹科學園區二廠所在地旁，面積 8,000 坪的土地上，開始動土興建地下二層、地上八層之新竹科學園區三廠，工程預計於 109 年上半年完成，並於同年下半年開始裝機量產，預估未來將可提供約 3,000 多個優質的工作機會，以迎接物聯網、人工智慧、無人駕駛、高速運算及生技產業即將到來的需求，預期對未來營運之擴展將有所助益。本公司已於投資前持續評估各項擴建廠房可能產生之資金不足、工程進度落後、業務接單狀況等風險，並擬定相關措施，以降低各項風險對公司營運之不利影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

由於所處之產業特性，上游記憶體 IC 之市場集中度高，使得下游封測產業出現銷貨及進貨較為集中之現象，為分散此風險，本公司積極開發新客戶，與原有客戶建立友好的策略聯盟合作關係，並持續積極跨足非記憶體 IC 之封裝測試業務，目前在 DRAM、NAND FLASH 及邏輯 IC 之封測代工呈現約各占 1/3 之態勢。進貨方面，則積極尋找替代料及新合格供應商，以期使公司穩健成長。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

1.本公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

2.董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。